

本期封面



2006年1

栏目:

DOI:

论文题目: 微量Zr对Cu-Ag合金磨损行为的影响

作者姓名: 刘平, 贾淑果, 郑茂盛, 任凤章

工作单位: 河南科技大学材料学院, 洛阳471039

通信作者: 刘平

通信作者Email: jiashuguo96@sohu.com

文章摘要: 采用真空熔炼的方法制备了Cu-Ag-Zr合金, 研究了微量Zr对Cu-Ag合金磨损行为的影响, 探讨了合金的磨损机理. 结果表明: Cu-Ag合金的磨损率随着Zr含量的增加明显减小, 随着受电电流和滑动距离的增大逐渐增大. 粘着磨损、磨粒磨损和电侵蚀磨损是主要的磨损机制. 微量Zr的加入使合金中形成弥散细小的析出相, 使其磨损性能明显优于Cu-Ag合金.

关键词: 金属材料; 接触线; Cu-Ag-Zr合金; 电流

分类号:

关闭